

厚膜电路包封环氧树脂胶 904A/6822B



一、简介:

包封型: 厚膜电路包封环氧树脂胶 904A/6822B 是一种双组室温硬化型 包封材料,它在固化后成为致密性固体结构,具有很高的硬度,耐热性能好,极难拆卸,可起到保护、防水、保密的作用。

二、常规性能:

测试项目	测试方法或条件	904A	6822B
外观	目测	黑色粘稠液体	无色透明液体
密度	25°C g/cm ³	1.5~1.6	1.08~1.15
粘度	25°C mpa·s	3000~5000	20~40
保存期限	室温通风	半年	半年

三、使用工艺:

项目	单位或条件	904A/6822B
混合比例	重量比	100 克:30 克
可使用时间	25°C, 35g, hrs	0.5
固化条件	°C/hrs	25/24 或 60/3

四、用途: 适用于传感器,混合模块电路,小型电子元件等包封。

五、固化后特性:

项目	单位或条件	904A/6822B
硬度	Shore-D	80
体积电阻率	25°C, Ω·cm	1.0×10 ¹⁴
绝缘强度	25°C, kV/mm	15
冲击强度	Kg/cm ²	7
介电常数	25°C, 1MHZ	4.0±0.05
介质损耗角正切	25°C, 1MHZ	0.02

六、贮存、运输及注意事项:

1. 此类产品非危险品,按一般化学品贮运,产品贮存期见包装桶。
2. 请看准所使用产品型号,然后对号入座;准确称量后,请充分搅拌均匀。
3. 包封时注意浸渍速度不宜过快,以确保浸渍均匀。

七、包装规格: 包装为 5KG 或 25KG 金属容器。

备注: 以上性能数据为该产品于湿度 70%、温度 25°C 时测试之典型数据,仅供客户使用时参考,并不能完全保证于某个特定环境时能达到的全部数据。敬请客户使用时,以实测数据为准。